


注1.適合基板厚：1.6mm
2.溶着用レグは基板裏側から基板との浮きが無いよう確実に溶着し固定すること。
3.パターン禁止区域（コネクタ実装面）
4.レグ溶着時は3mm以上であること。
5.図示の位置に社標、金型マーク、材料名の表示を行う。
6.図示の位置に組立ロットの表示を行う。

5	025 TERMINAL	1	COPPER ALLOY	TIN PLATING	_____
4	INNER TERMINAL	1	COPPER ALLOY	SELECTIVE GOLD PLATING SELECTIVE TIN PLATING	_____
3	OUTER TERMINAL	1	COPPER ALLOY	TIN PLATING	_____
2	BRACKET	1	COPPER ALLOY	TIN PLATING	_____
1	HOUSING	1	GF PBT	(COLOR: LIGHT GRAY)	_____
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-20084		第1版 (ORIGINAL DATE) 10.May.2007		尺度 (SCALE) 2:1	シリーズ (SERIES) GE2
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	 日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 図面番号 (DRAWING NO.) SJ107599		
寸法 (DIMENSION)		相当 CHK.			
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.			
		承認 APPD.			
. ±0.8 .X ±0.4 .XX ±0.1 .XXX ±		H.MIZUSHINA T.MIYASHITA G. Sugii		名称 (TITLE) CE2S111C01 質量 (MASS)	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[CE2S111C01](#)